

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2026 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，根据 2026 年上半年公司对 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告，具体如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者

2026 年上半年，公司继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车规级、工业级）的测试需求。公司 2026 年上半年实现营业收入 107,185.98 万元，同比增长 69.00%，其中，公司第二季度实现营业收入 58,188.42 万元，单季度营收创出历史新高。2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,931.11 万元，较上年同期增长 57.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,575.19 万元，较上年同期增长 171.33%，盈利能力持续提升，经营业绩迈上新台阶。

（一）继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，积极把握国产替代及下游战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩快速增长

公司是第三方集成电路测试行业中规模最大的内资企业之一，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。当前，人工智能已成为驱动集成电路行业高质量发展的核心引擎，大模型训练与推理需求的爆发式增长，直接带动算力芯片、高带宽存储芯片等关键产品供不应求。

公司积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车规级、工业级）、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试需求，积极把握国产替代及 AI、新能源汽车、工业控制等战略新兴产业的发展机遇，实现公司业绩的快速增长，以优异的业绩回报投资者，致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商。

（二）积极推进投资项目，扩大测试产能，加快上海总部基地、成都项目的建设，为公司业绩的持续增长奠定产能基础

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC 芯片、GPU、CPU 等 AI 算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。AI 从模型训练走向实际应用这一趋势驱动产业进入“超级周期”，AI 大模型爆发使存储芯片升级为稀缺物资，我国产业正处于 AI 驱动与国产替代交汇的机遇期，有望在未来 5-10 年开创“中国存储时代”。国内领先企业实现高端 CIS 芯片技术突破后销量大幅增长有望带来强劲的测试需求。

2026 年 5 月，公司启动新一轮再融资计划，拟募资 70,000 万元投资“伟测科技上海总部基地项目”，2026 年上半年，公司预先使用自有资金推动上海总部基地建设有序开展，预计年底陆续搬入；拟募资 80,000 万元投资“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，重点购置 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试机台。

（三）继续加大研发投入力度，为公司的快速发展提供技术支撑

2026 年上半年，公司研发费用为 8,998.21 万元，较上年同比增长 9.56%，在研项目 18 个，其中重点研发基于硅通孔（TSV）工艺高性能 AI 产品整体测试方

案、3D 堆叠封装芯片成品软硬件测试方案、半导体测试全场景 AI 图像识别系统、3D 高性能人工智能芯片测试方案、基于 GPIB 协议的 Handler/Prober 测试设备统一控制系统、基于 2.5D 封装工艺高性能光计算芯片晶圆测试方案、2.5D 封装超高并行度高性能服务器高速数据交换芯片测试方案、AI 算力芯片成品测试方案等。公司正凭借其前瞻性的技术布局，在芯片测试领域构筑起宽广的“护城河”，其强大的技术开发能力与落地效率，为公司未来的业绩增长注入了强劲的确定性。

公司采取阶梯式培养研发储备人员的培养方式，持续加大研发人员培养力度。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员数量 593 人，占 2026 年 6 月 30 日公司总人数的 18.33%。

（四）积极开拓市场，不断提升市场占有率

公司现有客户已经超过 200 家，不乏国内知名的集成电路设计公司，以及部分晶圆厂、封装厂及 IDM 公司，经过数年发展，公司已与广大客户建立了长期稳定的合作关系，客户基础稳固。为广泛拓展市场、深挖潜在客户，公司 2026 年积极参与 “SEMICON/FPD China 2026” 进一步提升品牌曝光度，强化品牌形象，提升市场覆盖范围。2026 年 3 月 25 日，公司成功举办“异构聚力 智算未来”年度技术研讨会暨行业伙伴交流会。会议汇聚了半导体先进测试、验证、设备等领域的一线专家与企业代表，围绕 AI 与高性能计算时代下芯片测试与可靠性验证的前沿挑战与解决方案，展开深度分享与交流。公司坚持技术创新大力开拓市场。

二、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

2026 年上半年，为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2026 年 6 月 29 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的

议案》，为进一步提高公司董事会运作效率，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司将董事会成员人数由 8 人调整为 6 人，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

三、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2026 年上半年，公司通过“上证 e 互动”、投资者热线、公司邮箱、业绩说明会、电话会、网上路演、股东会等形式与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据及公司未来发展战略。通过组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通；通过积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。

四、完善投资者回报机制，继续保持不低于 30% 的现金分红比率，提升公司投资价值

公司自 2022 年上市以来重视对投资者的回报，公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策，公司重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。

公司于 2026 年 6 月 24 日完成现金红利分派，共分派 92,448,598.55 元，现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.49%。自 2022 年 10 月 26 日在科创板上市至今，公司已累计现金分派约 2.42 亿元。公司坚持合理回报股东，利润分配政策保持持续性和稳定性，兼顾实际经营与长期战略目标。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束

（一）制定与经营业绩相挂钩的高管薪酬政策

2026年4月20日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）通过业绩考核强化股权激励约束机制

2026年上半年，公司按计划落实限制性股票激励计划的归属及登记流程，2026年5月与6月，董事会先后审议2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件成就的相关议案，并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。2026年5月22日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属登记完成。股权激励计划的有序落地，在稳队伍、提效能、强信心三个方面发挥了切实作用。核心人才队伍保持稳定，关键岗位流失风险明显降低，员工的归属感与凝聚力进一步增强；分期归属与动态考核机制有效激发了组织活力，推动人才向高价值岗位有序流动，优化了人力配置。同时，激励计划的顺利推进也印证了公司良好的经营治理水平，并向市场传递出核心团队对公司长期发展的坚定信心。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年8月27日